

2024年度 大阪公立大学 半導体デバイスプロセス技術基礎講座 (会員有料制)

於:大阪公立大学 i-siteなんば および オンライン



| | | | | |
|------|--------|------------------------------------|-----------|----------------------|
| 第1回 | 4月24日 | 最新の国内・世界の半導体および市場動向と展望 | 和田木 哲哉 氏 | モルガンスタンレーMUFJ証券(株) |
| 第2回 | 5月9日 | ALD/ALEプロセスの基礎と応用 | 霜垣 幸浩 教授 | 東京大学 工学系研究科 |
| 第3回 | 5月20日 | リソグラフィの基礎と最先端の現状 | 永原 誠司 氏 | 東京エレクトロン(株) |
| 第4回 | 6月7日 | プラズマエッチングの基礎と最先端の現状 | 堀 勝 特任教授 | 名古屋大学 低温プラズマ科学研究センター |
| 第5回 | 7月19日 | パワーデバイスの基礎と最新動向 | 上田 哲三 氏 | パナソニックインダストリ(株) |
| 第6回 | 8月9日 | 半導体IC設計技術とその最新動向 | 吉河 武文 教授 | 富山県立大学 理工学研究科 |
| 第7回 | 8月30日 | 半導体チップレットと3D集積の基礎と最先端 | 井上 史大 准教授 | 横浜国立大学 工学研究院 |
| 第8回 | 9月27日 | 半導体洗浄技術の基礎と最先端技術トレンド | 岩畑 翔太 氏 | Screenホールディングス(株) |
| 第9回 | 10月21日 | レジスト、感光性ポリイミドの基礎と最先端動向 | 上野 巧 特任教授 | 信州大学 |
| 第10回 | 11月27日 | 半導体支持基板の基礎と最新状況 | 片桐 規貴 氏 | 新光電気工業(株) |
| 第11回 | 12月4日 | 最先端半導体デバイスBig3の前工程プロセス・デバイス技術とその展望 | 廣田 良浩 氏 | ワイドヴィル |
| 第12回 | 12月18日 | CVDの基礎と応用 (仮) | 霜垣 幸浩 教授 | 東京大学 工学系研究科 |
| 第13回 | 1月8日 | Siトランジスタのスケーリング基礎と最先端 (仮) | 平本 俊郎 教授 | 東京大学 生産技術研究所 |
| 第14回 | 1月20日 | メタバースの基礎と最先端 (仮) | 福嶋 功太郎 氏 | カワサキテクノリサーチ(株) |
| 第15回 | 2月5日 | めっき技術基礎と応用 (仮) | 藤原 裕 氏 | (地独)大阪産業技術研究所 |
| 第16回 | 2月20日 | スパッタリング技術の基礎と最先端 (仮) | 恒川 孝三 氏 | キャノンアネルバ(株) |